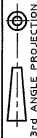


NUMBER 178327

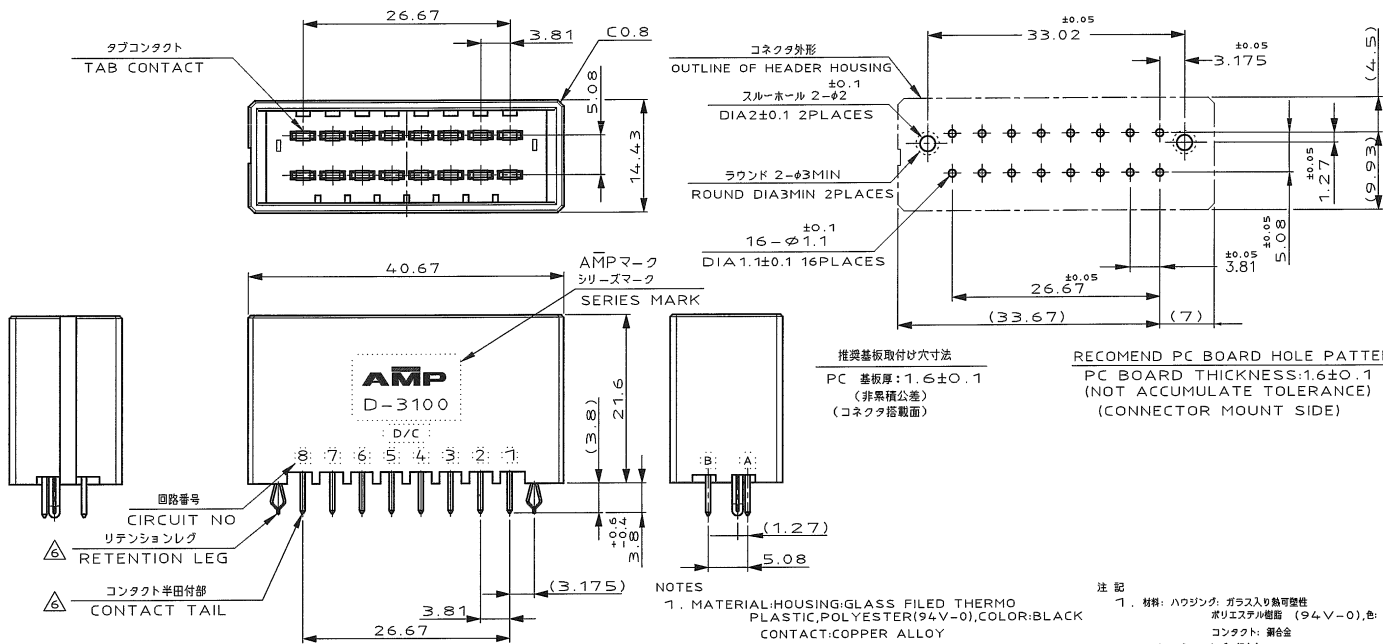


METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J  
REV.10/93



推奨基板取付け寸法  
PC 基板厚: 1.6±0.1 (非累積公差) (コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN  
PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1 (NOT ACCUMULATE TOLERANCE) (CONNECTOR MOUNT SIDE)

- NOTES
- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILED THERMO PLASTIC, POLYESTER (94V-0), COLOR: BLACK  
CONTACT: COPPER ALLOY  
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
  - FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
  - FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
  - FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
  - FINISH (RETENTION LEG): TIN LEAD PLATED
  - FINISH (CONTACT TAIL): OVER NICKEL
  - FINISH (CONTACT TAIL): TIN PLATED
- 注記
- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 (94V-0), 色: 黒  
コンタクト: 銅合金  
リテンションレグ: 銅合金
  - めっき: コンタクト: 全面 Ni 下地 接触部: 0.38 μm MIN 金めっき
  - めっき: コンタクト: 全面 Ni 下地 接触部: 0.76 μm MIN 金めっき
  - めっき: コンタクト: 全面 Ni 下地 接触部: 2.0 μm MIN スズめっき
  - めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部: ニッケル下地の土付半田めっき
  - めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部: ニッケル下地の上にスズめっき

△	△	178327-5
△	△	178327-3
△	△	178327-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE
E	REVISED	FJD	TSS	19 APR 94
D	REVISED	FJD	TSS	16 APR 93
C	REVISED	FJD	KIY	16 JUN 93
B	REVISED	FJD	NM	7/4 '94
A	REDRAWN WITH CHANGE	FJD	NM	4/20 '94

Copyright © 1994 AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		WIRE RANGE		INSULATION DIA		NAME	
		mm(TAWG - )		mmφ		16 POS DOUBLE ROW VERTICAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC D-3100	
MATERIAL		SEE NOTE		FINISH		SEE NOTE	
注記参照		注記参照		注記参照		注記参照	
DR. N. Matsubara		19 APR 94		DE. N. Matsubara		19 APR 94	
CHK. S. MANGA		28 APR 94		APP. S. MANGA		28 APR 94	

tyco Electronics		Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
GENERAL TOLERANCE		SIZE LOC NUMBER	
A3 J		C-178327	
SCALE 2-1		REV. E SHEET 1 OF 1	

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面